

御得意様各位

第20回 半導体・センサパッケージング技術展 出展のご案内

拝啓

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて弊社はこのたび「半導体・センサパッケージング技術展」において実績豊富な電子部品・半導体パッケージング
プロセス用の表面処理技術を多数出展いたします。
是非ご来場賜り、弊社出展品をご高覧頂きたくご案内申し上げます。

敬具

記

日時：2019年1月16日(水)~1月18日(金)

開場時間：10：00~18：00

※最終日は17：00まで

会場：東京ビッグサイト：東3ホール・E23-28

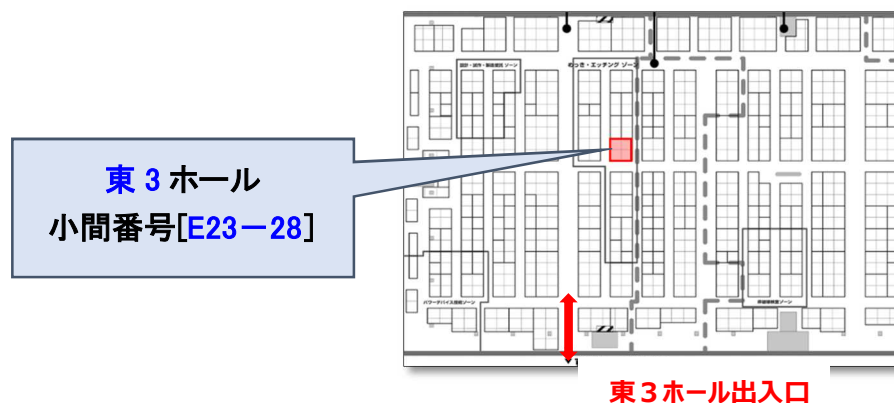
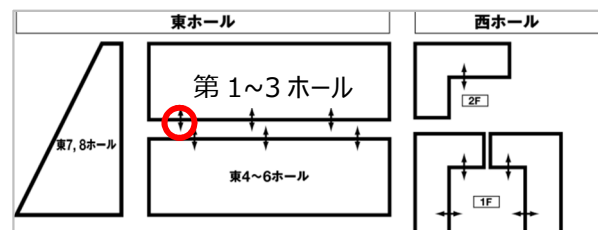
【弊社ブース】

会場：東京ビッグサイト

東3ホール・E23-28

最寄駅：ゆりかもめ『国際展示場正門』

りんかい線：『国際展示場』



【展示品】

□メルプレートUBMプロセス	半導体アルミニウム電極上に無電解ニッケル-置換金めっきによりUBM (Under Barrier Metal) を形成するプロセスです。大面積電極を有するデバイスへの安定しためっき処理も可能です。
□半導体ウェハ用シード層エッチング液	銅スパッタシード層及びチタンスパッタバリア/シード層のエッチング液を各種取り揃えています。
□半導体ウェハ用ドライフィルム剥離剤	TMAH フリーの半導体ウェハ用厚膜ドライフィルム剥離剤です。 LtF S-45 : ドライフィルム剥離剤 銅の溶解を抑制し微細パターンのドライフィルムを剥離できます。
□Fan-Out パッケージングプロセス製品 - LtF プロセス -	LtF E-52 : 銅シード層エッチング液 ハロゲンフリーでアンモニアアルカリ性エッチング液です。 LtF E-53 : チタンシード層エッチング液 過酸化水素系弱アルカリ性のエッチング液。 スプレー処理が可能です
□リードフレーム用銅及び銅合金表面粗化剤	各種リードフレーム材の表面を均一かつ微細に粗化し、モールド樹脂との密着性を向上させます。

【プリント配線板 EXPO セミナー】

プリント配線板 EXPO 専門セッションにて弊社技術開発部 渡口が「微細配線形成にむけた M-SAP 工法における表面処理薬品の動向」について講演を行います。

【講演内容】

M-SAP 工法で行われる DFR 剥離やシード層エッチング工程で用いられる薬品について概要を説明し、微細配線形成への対応やエッチングの維持などの課題に対する薬品側からのアプローチについて紹介いたします。

【プロフィール】

技術開発部 基礎技術開発グループ 基礎技術開発課チームリーダー 渡口 繁

2006年メルテックス(株)入社。技術開発部に所属し、各種めっき液、エッチング剤の開発及び表面処理薬品の分析、解析技術の開発を担当。理学博士

【講演詳細】

日 時 : 2019年1月16日

時 間 : 9:30~12:00

※渡口のセミナーは10:45頃開始いたします。

セッション番号 : PWB-2

料 金 : ¥27,000

※PWB-2すべてのセッションを聴講いただけます。

場 所 : 東京ビッグサイト会議棟